



1064nm宽线宽系列单模激光模块

Key Features

采用DoGain自研芯片

低应力14pin蝶形封装

工作温度范围-5°C至75°C

高效率TEC温度控制 ($T_s=25^{\circ}\text{C}$)

独有的耦合封装技术, 高效率, 高稳定性

可选单模光纤/FC/PC接头

符合RoHS, REACH标准

Applications

光纤激光器

传感

种子源

1064nm Cooled Laser Module DG-HS03 Series



*产品图片仅供参考, 最终实物以发货为准

HS03系列1064nm单模激光模块采用自主研发芯片, 经过严格的性能、可靠性筛选, 保障了激光模块的卓越性能和可靠性水平。

14-Pin低应力、高气密蝶形封装形式, 保证光纤稳定输出功率 > 500mW。

HS03系列产品包含热电冷却器(TEC), 精密的NTC热敏电阻和背面监测光电二极管。

1064nm Cooled Laser Module

DG-HS03 Series



1. 光电特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

1.1最大额定值 Absolute Maximum Ratings

序号 Item	模块参数 Module parameter	符号 Symbol	条件 Condition	限度Limits		单位 Unit
				最小值 Min.	最大值 Max.	
1	LD正向电流 LD Forward Current	I _f			1.5	A
2	LD反向电压 LD Reverse Voltage	V _r			2	V
3	LD反向电流 LD Reverse Current	I _r			10	μA
4	PD反向电压 PD Reverse Voltage	V _{PD}			20	V
5	PD正向电流 PD Forward Current	I _{PF}			10	mA
6	LD 静电释放 LD Electrostatic Discharge (ESD)	V _{ESD LD}	C = 100 pF, R = 1.5 kΩ, human body model		1000	V
7	PD 静电释放 PD Electrostatic Discharge (ESD)	V _{ESD PD}	C = 100 pF, R = 1.5 kΩ human body model		500	V
8	管壳工作温度 Operating Case Temperature Top	T _{op}		-5	75	°C
9	相对工作湿度 Operating Relative Humidity	RH _{OP}	非冷凝 Noncondensing	5	95	%
10	相对存储湿度 Storage Relative Humidity	RH _{stg}		5	95	%
11	存储温度 Storage Temperature	T _{stg}	2000 hr	-40	85	°C
12	引线焊接时间 Lead Soldering Time		300°C		10	s
13	轴向拉力 Axial Pull Force		3 x 10 s		5	N
14	侧拉力 Side Pull Force		3 x 10 s		2.5	N
15	光纤弯曲半径 Fiber Bend Radius			15		mm

Notes:

* BOL for T_{Submount}= 25°C, T_{case}= -5°C to 75°C

* EOL forward current I(EOL)= 1.1x I(BOL)

* 规格参数, 如无特别说明, 都指适用于全温工作范围 (T_{case}=-5~75 °C)

1064nm Cooled Laser Module
DG-HS03 Series



1.2 可用的峰值波长选择 (Available Peak Wavelength Selection)

产品代码 Product Code	中心波长最小值 Minimum Center Wavelength	中心波长最大值 Maximum Center Wavelength
DG-HS03-6425B-xxxxx-Wxxx	1060nm	1070nm

1.3 Hi 1060光纤标称特性和公差 (Hi 1060 Fiber Nominal Characteristics and Tolerances)

参数 Parameters	规格 Specification
截止波长 Cutoff wavelength	920±50 nm
980 nm 处的最大衰减 Maximum attenuation at 980 nm	2.1 dB/km
包层外径 Cladding outside diameter	125 ±0.5 μm
涂覆层外径 Coating outside diameter	245 ±10 μm
芯包层同心度 Core-cladding concentricity	≤0.3 μm
模场直径 Mode field diameter	5.9 ±0.3 μm

1064nm Cooled Laser Module
DG-HS03 Series



1.5性能规格 Performance Specification

序号 Item	模块参数 Module parameter	符号 Symbol	条件 Condition	限度Limits		单位 Unit
				最小值 Min.	最大值 Max.	
1	阈值电流 Threshold Current	I_{th}		-	100	mA
2	光纤输出功率范围*1 Fiber Output Power Range*1	P_f		30	500	mW
3	正向工作电流 Operating Forward Current	I_{op}	连续电流以保持输出功率 Continuous current to maintain output power P_{op}	-	1400	mA
4	正向电压 Forward Voltage	V_f	$I_f = I_{op}$	-	2.0	V
5	光谱宽度 Spectral Width	$\Delta\lambda_{RMS}$	$50\text{ mW} < P_f < P_{op}$	20	30	nm
6	中心发射波长*2 Center Emission Wavelength*2	λ_m	覆盖 P_f 范围 Over P_f range	1060.0	1070.0	nm
7	光电二极管响应 Monitor Diode Response	R_m	At $P_{op}, V_R=5V, \lambda=1550nm$	0.3	-	A/W
8	光电二极管暗电流 Monitor Diode Dark Current	I_{dark}	在整个温度范围内保持5V 反向偏置 5V reverse bias, over the whole temperature range	-	4	nA
9	热敏电阻阻值 Thermistor Resistance	R_{th}	$T_{set} = 25^{\circ}C$	9.5	10.5	k Ω
10	热敏电阻系数 Thermistor Constant	β	$\pm 1\%$ 温度变化 $\pm 1\%$ temperature variation	3750	4150	K
11	半导体制冷器电流 TEC Current	I_{TEC}		-0.9	4.4	A
12	半导体制冷器电压TEC Voltage(BOL/EOL)	V_{TEC}		-2.4	4.3	V

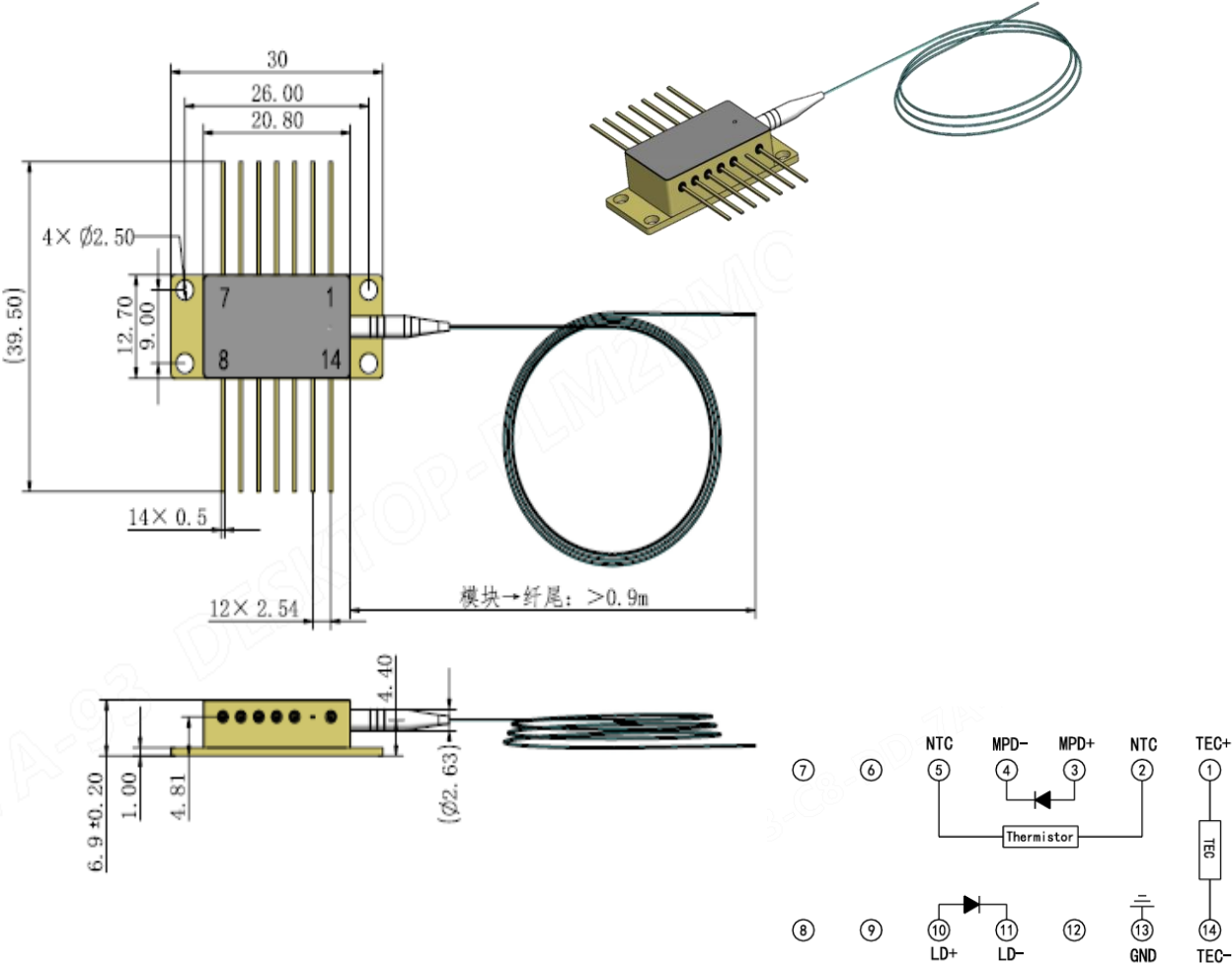
Notes:
*1 根据客户需求可定制光纤输出功率30~500mW
*2 中心波长在1060~1070nm

1064nm Cooled Laser Module
DG-HS03 Series



2. Dimensions & Pin Assignment

2.1 尺寸图 / Dimensions Diagram



2.2 引脚分配 / PIN ASSIGNEMENT

Pin	Description	Pin	Description
1	TEC正极/Cooler (+)	8	空/N/C
2	热敏电阻/Thermistor	9	空/N/C
3	PD正极/Monitor PD anode (-)	10	激光器正极/Laser anode
4	PD负极/Monitor PD cathode (+)	11	激光器负极/Laser cathode
5	热敏电阻/Thermistor	12	空N/C
6	空/N/C	13	地/ground
7	空/N/C	14	TEC负极/Cooler (-)

1064nm Cooled Laser Module
DG-HS03 Series



3. 产品订购信息

- Fiber Output Power: 30~500mW
- SM-Hi1060 Fiber or FC-UPC/APC连接头
- DG P/Number: DG- HS03-6425B-xxxxx-Wxxx*

DG-HSxx	64 25B	xxx (Code)	xx	Wx	x	x
HS03: 14-pin butterfly package	64 : Wavelength Specification 1060~1070nm 25 : T _{Submount} =25°C B : T _{case} =-5~75°C	Fiber Output Power: 100:100mW 200:200mW 300:300mW 400:400mW 500:500mW	SM: Corning HI1060 Single Mode Fiber or Equivalent	W2: Wide 20- 30nm BandWidth	C: Constant power P: Rated power	Y: Photo diode N: No Photo diode

* Example: DG-HS03-6425B-500SM-W2PY-FC/APC
✓ 14pin蝶形封装, T_{Submount}=25°C, 500mW@Fiber Output Power , 3dB宽线宽20-30nm, 单芯出光
✓ Corning HI1060 Single Mode Fiber or Equivalent
✓ (-FC/APC) Customized connector or equivalent

4. 产品工作参数

Product Code	Maximum Operating Power Pop (mW)	Maximum Operating Current lop (mA)
6425B-100SM	100	400
6425B-200SM	200	600
6425B-300SM	300	900
6425B-400SM	400	1200
6425B-500SM	500	1400

* 6425B标识为1.2项中每个产品代码的波长。
* 度亘核芯还可以开发定制产品, 以满足广泛的技术要求。
* 请联系你的销售经理了解详情。

1064nm Cooled Laser Module
DG-HS03 Series



■ 1064nm单模激光模块- HS03系列

Corning Hi1060 Fiber	$\lambda_p = 1060 \sim 1070 \text{nm}$, $T_{\text{submount}} = 25^\circ\text{C}$
Nominal Power	Customer Part Number
100mW	DG-HS03-6425B-100SM-W2PY
200mW	DG-HS03-6425B-200SM-W2PY
300mW	DG-HS03-6425B-300SM-W2PY
400mW	DG-HS03-6425B-400SM-W2PY
500mW	DG-HS03-6425B-500SM-W2PY

5. 使用说明

- 输出激光是不可见光，使用时须遵守 IEC四级激光标准安全规范，避免激光直接或间接照射眼睛。
- The laser beam is invisible, please follow the standard safety procedures for IEC Class 4 lasers, avoid eyes exposure to radiation.
- 静电击穿导致半导体激光器失效，激光器安装人员须经过培训，操作时须佩戴防静电手腕带，工作台需接地；在供电连接头与激光器连接前，正负极应处于短接状态。
- ESD cause diode laser failure, The operator should be trained, wearing ESD grounding straps and the work surface should be grounded. The positive and negative poles shall be connected before the power supply is connected with the laser.
- 电流过冲可能损坏激光器，驱动电源须稳定无过冲。
- The current overshoot may damage the laser, and the driving power must be stable without overshoot.
- 超规格使用会导致激光器寿命下降，请严格按照产品规格书进行使用。
- Reduced lifetime if used above nominal operating condition, Please strictly follow the product specifications for use.

For more Info

度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司
http: //www.dogain.com
电话: +0512-62385166 / 61790076 - 8071

